

Willkommen bei O-Leading

O-Leading ist bestrebt, Ihr One-Stop-Lösungspartner in der EMS-Lieferkette zu sein, einschließlich Leiterplattendesign, Leiterplattenherstellung und Leiterplattenbestückung (PCBA). Wir bieten einige der fortschrittlichsten Leiterplattentechnologien, einschließlich HDI-Leiterplatten, Mehrschicht-Leiterplatten und starrflexiblen Leiterplatten. Wir können vom schnellen Prototyp bis zur mittleren und Massenproduktion unterstützen.

Im Allgemeinen sind unsere globalen Kunden von unseren Dienstleistungen sehr beeindruckt: Schnelle Reaktion, wettbewerbsfähiger Preis und Qualitätsverpflichtung. Die Bereitstellung eines wertvolleren technischen Service und einer Gesamtlösung ist der Weg nach vorne.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich O-Leading wie immer auf die Innovation und Entwicklung der Elektronikfertigungstechnologie konzentrieren und sich konsequent um PCB- und PCBA-One-Stop-Service bemühen, um erstklassige Services bereitzustellen und mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen.

BITTE KLICKEN SIE AUF DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Net Power Module Hersteller China](#)

Produktbeschreibung

Beschreibung:

HF1R0x ist ein Hexabitz Raspberry Pi-Schnittstellenmodul. Es lässt sich nahtlos an Raspberry Pi 3B / 4B-Einplatinencomputer anschließen und ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Hexabitz-Module über das Raspberry Pi-Betriebssystem anzuschließen und zu steuern und Ihren eigenen Raspberry Pi Hat zu erstellen. Dies ist das weltweit erste selbstgebaute Pi-Hat-System!

- * Schließen Sie alle Hexabitz-Module in horizontaler und vertikaler Konfiguration über die serielle Raspberry Pi UART-Schnittstelle an Raspberry Pi 3B / 3B + / 4B an.
- * Kleiner Formfaktor mit Optionen zum Anschließen von Hexabitz-Modulen rund um die Schnittstelle und zum Versorgen der Module über die integrierte 3,3-V-Versorgung von Raspberry Pi.
- * Ultimative Freiheit bei der Gestaltung der Funktionalität und Form Ihres eigenen Raspberry Pi Hat gemäß Ihren Anforderungen.
- * Kann mit Hexabitz M2 / M2.5 / M3 / M4-Montagelochmodulen (H00R1) kombiniert werden, um einen starren und gut abgestützten Hut zu bilden.
- * Steuern und kommunizieren Sie mehrere Hexabitz-Module gleichzeitig, indem Sie über unsere Explorefunctionality ein Array definieren.
- * Verwenden Sie unsere C ++ Hexabitz-Schnittstellenbibliothek unter Raspbian, Ubuntu oder anderen kompatiblen Linux-Distributionen in Ihren C ++ - oder Python-Anwendungen.
- * Das HF1R0x-Schnittstellenmodul entspricht (soweit möglich) den Raspberry Pi Hat-Spezifikationen und wird mit einem eingebetteten EEPROM geliefert, das mit Hat-Kennungen und zugehörigen Informationen

programmiert ist. Das Modul kann beim Hochfahren des Linux-Systems automatisch identifiziert und eingerichtet werden.

Spezifikationen:

Vorderes Ende

- * Physisch und elektrisch kompatibel mit Raspberry Pi 3B, 3B +, 4B (1 GB), 4B (2 GB) und 4B (4 GB).
- * ON Semiconductors CAT24C32WI-GT3 32-Kb-I2C-EPROM
- * Schreibschutz-Jumper (WP) zum Programmieren des EEPROM vom Raspberry Pi.
- * Raspberry Pi GPIO-Schnittstelle: Sullins Connector Solutions PPTC202LFBN-RC oder kompatibler 40-poliger, zweireihiger (2 × 20) Durchgangsloch-Steckverbinder mit 2,54 mm Abstand. Es sind kurze (3,20 mm) und lange (12 mm) Kontaktlängenstecker erhältlich.
- * 2 x M2-Befestigungslöcher (2,75 mm Durchmesser), kompatibel mit den Spezifikationen des Raspberry Pi Hat.

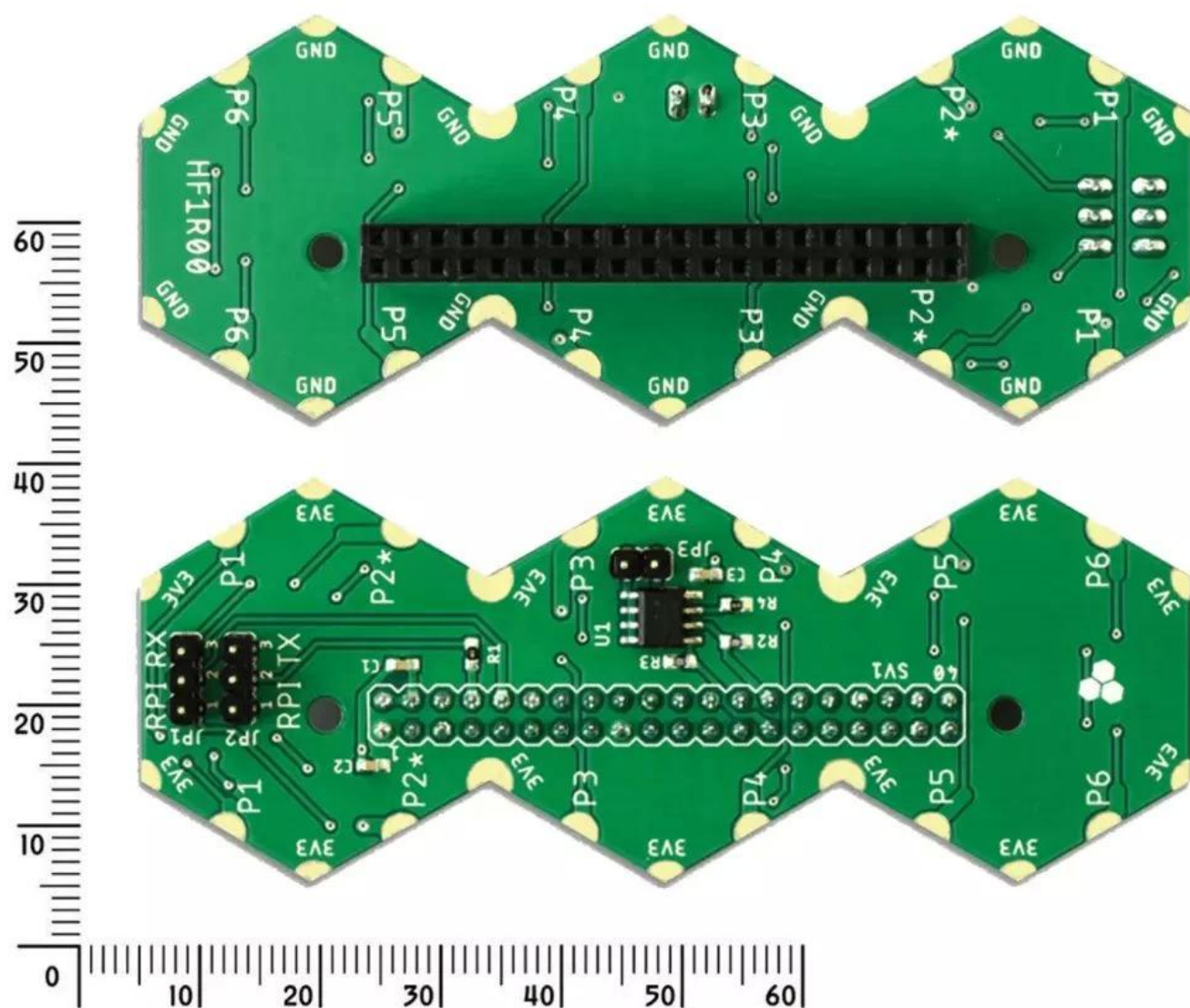
Backend

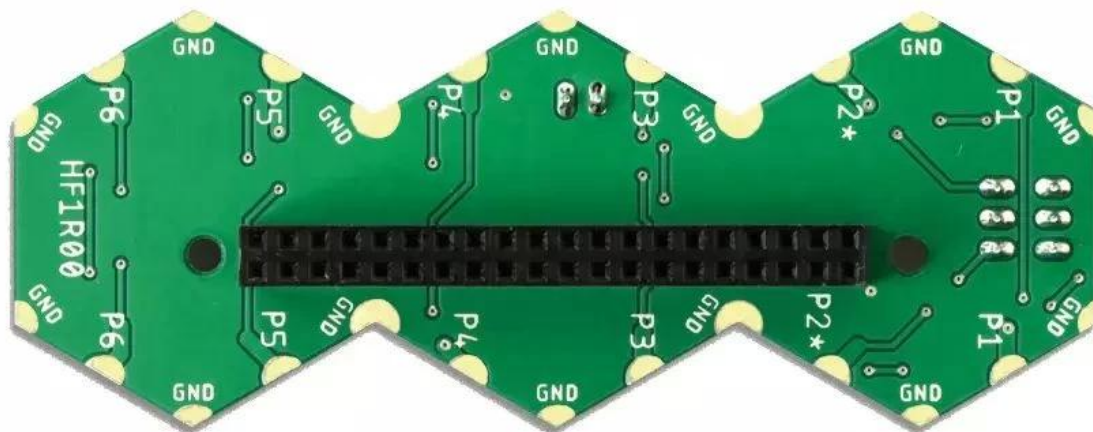
- * Sechs Hexabitz-kompatible Array-Ports und 14 Stromanschlüsse (+ 3,3 V und GND).
- * P2 wird an die serielle Raspberry PI-Schnittstelle (RXD0, TXD0) angeschlossen. Sie können mithilfe von Jumpern auswählen, welche Seite der Schnittstelle mit dem seriellen Raspberry Pi-Port verbunden ist.
- * Die Array-Ports P1, P3, P4, P5 und P6 sind physisch mit ihren gegenüberliegenden Ports über die Schnittstelle verbunden, sodass auf beiden Seiten der Schnittstelle gelötete Module direkt miteinander verbunden werden können.
- * Modul 3,3 V wird von der integrierten 3,3-V-Stromversorgung von Raspberry Pi geliefert.

Physikalische Eigenschaften

- * Form: 3 x Sechseck
- * Größe: Einzelsechseck: 30 mm kurze Diagonale, 17,32 mm Seite. Gesamtabmessungen: 90 mm x 34,64 mm.
- * Fläche: $23,4 \text{ cm}^2$
- * Gewicht: 14 g
- * Lötmaske Farbe: Dunkelgrün
- * Oberflächenbeschaffenheit: ENIG (Gold) oder HASL-LF (Zinn)

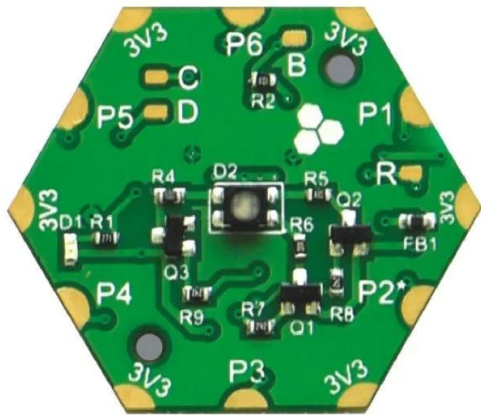
Optischer Modul Hersteller China







HEXABITZ QUICK START GUIDE

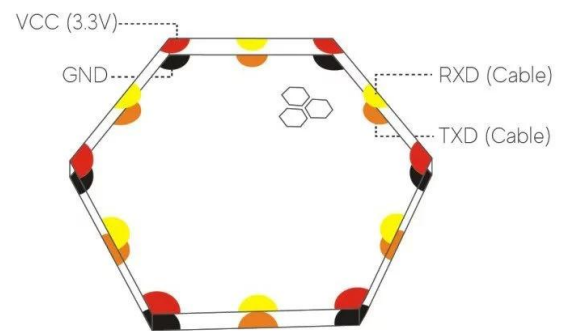
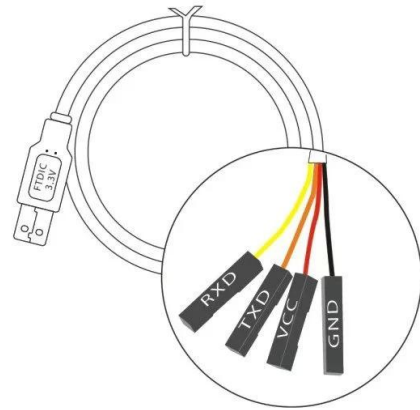


HOIROx RGB LED

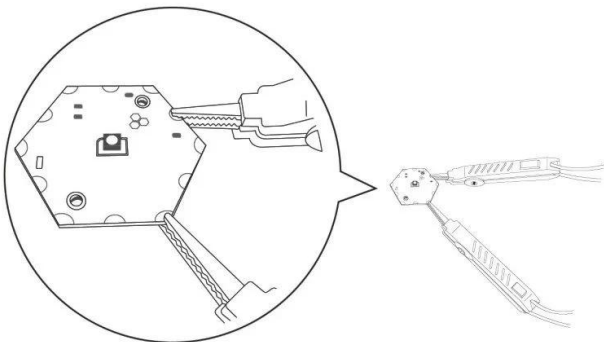
link



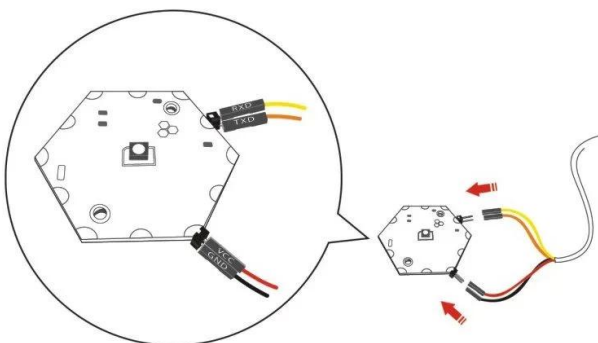
Re-37-19



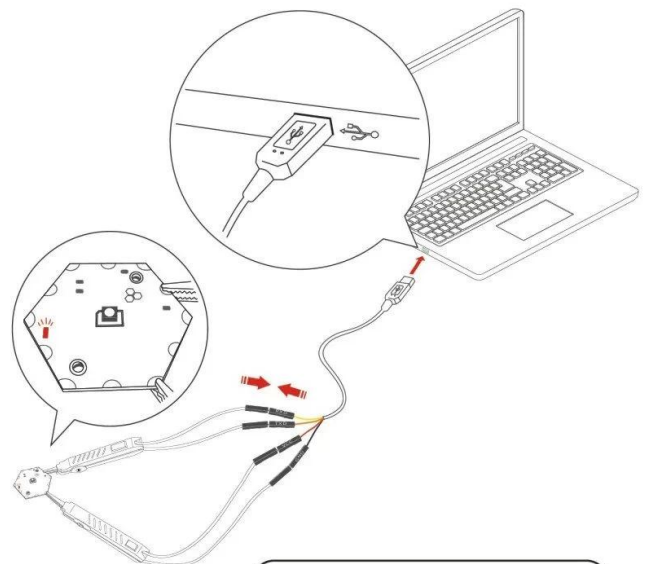
1



OR



2



**Need to
update firmware?**



link

3



RealTerm
(Windows)



Putty
(Windows/Mac/Linux)



SecureCRT
(Windows/Mac/Linux)

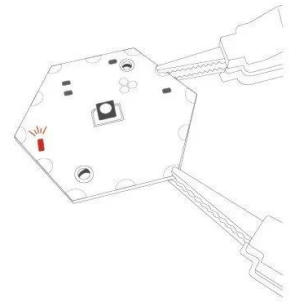
Use your favorite terminal software with these settings:

- o Baudrate: 921600
- o Display Format: Ansi
- o Parity: none
- o Data Bits: 8
- o Stop Blt: 1
- o Hardware Flow Control: none

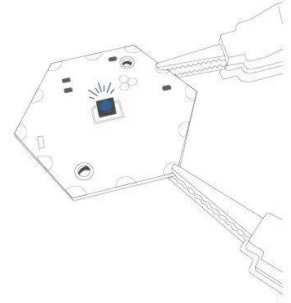
Open the virtual COM port and hit the ENTER key.
Module will respond with a welcome message.

Try some CLI commands:

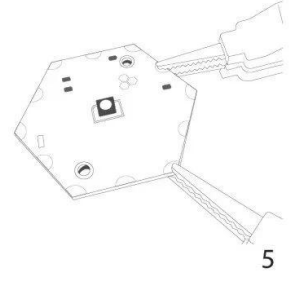
» ping



» color blue 30



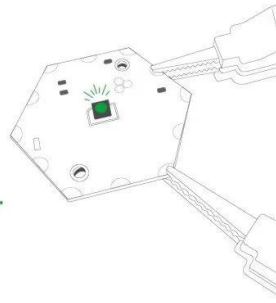
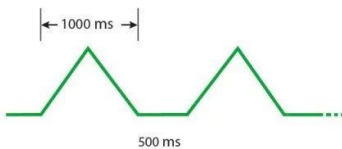
» off



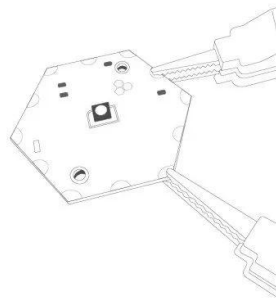
4

5

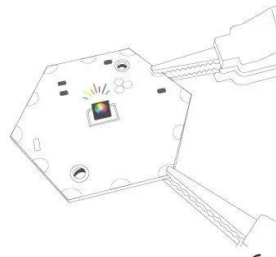
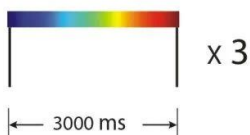
» dim green updownwait 1000 500 inf



» off



» sweep fine 3000 3



6

Type » help for more CLI commands.

Check module documentation, schematics, firmware
and design files in the Resources tab.



Resources



Related Projects

7

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

QUALITY IS OUR CULTURAL



Production Process

18 years experience in one-stop PCB and PCBA, we can make your idea come true,



Unser Team



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Zertifizierungen





Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313.FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ

Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Requested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method : Please refer to next page(s).

Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina

Tina Fan
Approved Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced or used, without prior written approval of the Company, for any advertisement, marketing, or for any other purpose. The content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

www.sgs.com/terms-and-conditions
SGS (Shenzhen) Standards Technical Services Co., Ltd. (hereinafter "SGS") is a member of the SGS Group (SGS SA).
中國·深圳·支那區新區中區430年工業區4樓405室 郵編: 518129 | 86-755-25328888 | 86-755-83106190 | www.sgs.com or sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	SZX19-005304.001	Green"PCB"

Remarks :

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test item(s)	Limit	Unit	MDL	Q/Z
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	8
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tri bromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tri bromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced or used, without prior written approval of the Company, for any advertisement, marketing, or for any other purpose. The content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

www.sgs.com/terms-and-conditions
SGS (Shenzhen) Standards Technical Services Co., Ltd. (hereinafter "SGS") is a member of the SGS Group (SGS SA).
中國·深圳·支那區新區中區430年工業區4樓405室 郵編: 518129 | 86-755-25328888 | 86-755-83106190 | www.sgs.com or sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max		Max		Meets C		UL796 T	DSR I
	Min	Min			Area	Solder	Oper	Flame				
	mm(in)	mm(in)			Diam	Limits	Temp	Class				
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-	
Multilayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-	
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-	
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*	
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*	

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Prozessfähigkeit

Produktionsmöglichkeiten für Leiterplatten		SMT-Produktionskapazitäten	
Ebenenanzahl	1Layer-32Layer	Leiterplattenmaterial	FR-4, CEM-1, CEM-3, Platte auf Aluminiumbasis
Fertige Kupferdicke	1 / 3oz-12oz		
Min. Linienbreite / Abstand intern	3,0 mil / 3,0 mil	Maximale Leiterplattengröße	510 x 460 mm
Min. Linienbreite / Abstand extern	4,0 mil / 4,0 mil	Min. Leiterplattengröße	50x50mm
Maximales Seitenverhältnis	10: 1	Leiterplattendicke	0,5 mm - 4,5 mm
Plattendicke	0,2 mm bis 5,0 mm	Plattendicke	0,5-4 mm
Maximale Panelgröße (Zoll)	635 * 1500 mm	Min. Komponentengröße	0201
Minimale Bohrlochgröße	4mil	Standard-Chipgrößenkomponente	0603 und größer
Plated Hole Tolerance	+/- 3mil	Komponente maximale Höhe	15mm
Blind / Buried Vias (All-Typen)	JA	Min. Bleipitch	0,3 mm
Über Füllung (leitend, nicht leitend)	JA	Min BGA Ball Pitch	0,4 mm
Basismaterial	FR-4, FR-4high Tg.Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid, schweres Kupfer	Platzierungsgenauigkeit	+/- 0,03 mm
Oberflächenbeschaffenheit	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersionssilber, Immersionsdose, Goldfinger, Carbon-Tinte		

Verpackung & Lieferung

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

- 1.1 Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
- 1.2 Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
- 1.3 Prüfgeräte und Werkzeuge nach dem neuesten Stand der Technik. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
- 1.4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
- 1.5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen.

O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft wird für beide Seiten von Vorteil sein, wenn wir Ihnen Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die PCB & PCBA-Produktion benötigt?

4.1 Stückliste mit Referenzbezeichnungen: Komponentenbeschreibung, Herstellername und Teilenummer.

4.2 PCB Gerber-Dateien.

4.3 PCB-Fertigungszeichnung und PCBA-Montagezeichnung.

4.4 Testverfahren.

4.5 Alle mechanischen Einschränkungen wie Anforderungen an die Montagehöhe.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innen-Trockenfilm → Innen-Ätzen → Innen-AOI → Mehrfachbindung → Schichtaufbau Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → Äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → Außenätzen → Äußere AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.

6. Was sind die wichtigsten Ausrüstungen für die HDI-Herstellung?

Die Liste der wichtigsten Geräte lautet wie folgt: Laserbohrmaschine, Pressmaschine, VCP-Linie, automatische Belichtungsmaschine, LDI usw.

Die Geräte, die wir haben, sind die besten in der Branche, Laserbohrmaschinen sind von Mitsubishi und Hitachi, LDI-Maschinen sind von Screen (Japan), automatische Belichtungsmaschinen sind ebenfalls von Hitachi, alle sorgen dafür, dass wir die technischen Anforderungen unserer Kunden erfüllen können.

7. Wie viele Arten von Oberflächenbeschichtungen kann O-Blei verarbeiten?

O-the Leader verfügt über die gesamte Palette an Oberflächen, wie z. B.: ENIG, OSP, LF-HASL, Vergoldung (weich / hart), Immersionsilber, Zinn, Versilberung, Immersionsverzinnung, Carbon-Tinte usw. OSP, ENIG, OSP + ENIG, die üblicherweise auf dem HDI verwendet werden. Wir empfehlen normalerweise, einen Client oder OSP OSP + ENIG zu verwenden, wenn die BGA-PAD-Größe weniger als 0,3 mm beträgt.

8. Was sind Ihre Fähigkeiten für FPC? Kann O-Leading auch SMT-Dienste anbieten?

O-Leading kann FPC von einer Schicht bis zu 8 Schichten herstellen. Die Größe der Arbeitsplatte kann bis zu 2000 mm * 240 mm betragen. Einzelheiten finden Sie auf der Seite „Flex Capability“.

Wir bieten unseren Kunden auch einen SMT-One-Stop-Service.

9. Was sind die Hauptfaktoren, die den Preis von Leiterplatten beeinflussen?

Material;

Oberflächenfinish;

Technologische Schwierigkeit;

Unterschiedliche Qualitätskriterien;

PCB-Eigenschaften;

Zahlungsbedingungen;

Verschiedene Herstellungsländer.

10. Was ist die Definition von PCB, PWB und FPC und was ist der Unterschied?

PCB ist die Abkürzung für Printed Circuit Board.

PWB ist die Abkürzung für Printed Wire Board und hat die gleiche Bedeutung wie Printed Circuit Board.

FPC ist die Abkürzung für Flexible Printed Board.

11. Welche Faktoren sollten bei der Auswahl des Materials für eine Leiterplatte berücksichtigt werden?

Die folgenden Faktoren sollten bei der Auswahl des Materials für die Leiterplatte berücksichtigt werden:
Der Tg-Wert des Materials sollte größer als die Betriebstemperatur sein.

Material mit niedrigem CTE weist eine gute Leistung der thermischen Stabilität auf;

Gute Wärmewiderstandsleistung: Normalerweise müssen Leiterplatten mindestens 50 Sekunden lang 250 °C widerstehen.

Gute Ebenheit; In Anbetracht der elektrischen Eigenschaften wird auf Hochfrequenz-Leiterplatten

Material mit geringem Verlust / hoher Permittivität verwendet; Polyimidglasfasersubstrat für flexible Leiterplatten; Metallkern wird verwendet, wenn das Produkt strenge Anforderungen an die

Wärmeableitung stellt.

12. Was sind die Vorzüge der rigid-flex-Leiterplatte von O-Leading?

Die Rigid-Flex-Platine von O-Leading hat die Eigenschaften von FPC und PCB und kann daher in einigen speziellen Produkten verwendet werden. Ein Teil ist flexibel, während der andere Teil starr ist. Dies kann dazu beitragen, den Innenraum des Produkts zu schonen, das Produktvolumen zu reduzieren und die Leistung zu verbessern.

13. Wie führen Sie die Impedanzberechnung durch?

Das Impedanzsteuersystem wird mit einigen Testcoupons, dem SI6000 soft und dem CITS 500s von POLAR INSTRUMENTS durchgeführt.

Das Gerät misst die Impedanz auf einem repräsentativen Gleiskonfigurationscoupon, von dem der Kunde uns einen bestimmten Wert und eine bestimmte Toleranz gegeben hat.